

2014年3月期 決算説明会

2014年5月13日
TOWA株式会社

東証1部:6315

本日の主な説明内容

1. 2014年3月期 業績結果
2. TOWA10年ビジョンと
新中期(3カ年)経営計画
3. 2015年3月期 取組み・計画

2014/3期 連結業績結果

(億円)

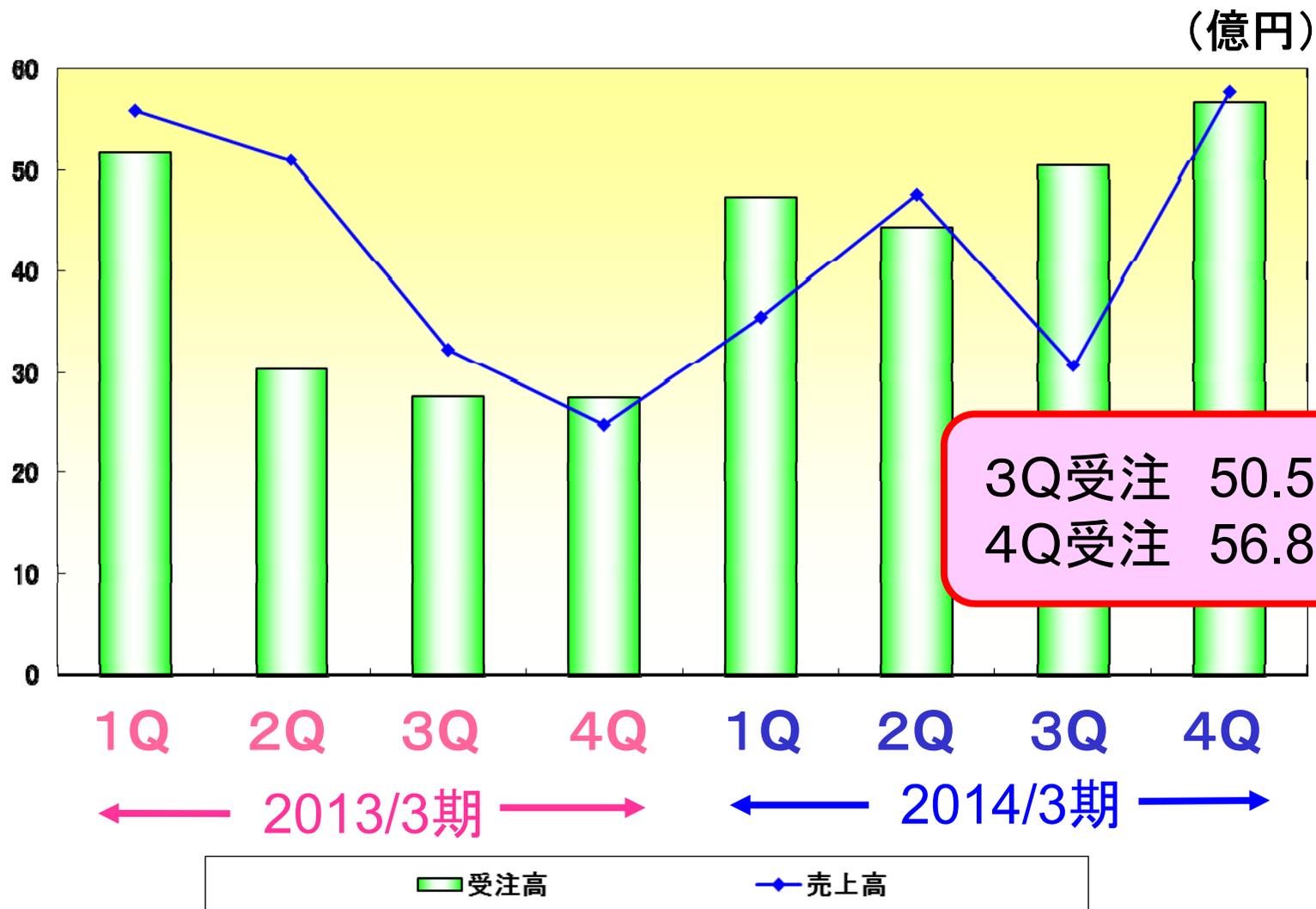
	通 期
売 上 高	171.7
営 業 利 益	4.6
経 常 利 益	6.7
当 期 純 利 益	5.7

2014/3期 連結業績結果

(億円)

	期 初 計 画	2013/10 修 正	実 績
売 上 高	<i>185.0</i>	<i>170.0</i>	<i>171.7</i>
営 業 利 益	<i>11.0</i>	<i>2.4</i>	<i>4.6</i>
経 常 利 益	<i>10.0</i>	<i>2.7</i>	<i>6.7</i>
当 期 純 利 益	<i>9.0</i>	<i>2.2</i>	<i>5.7</i>

受注高・売上高の推移



2014/3期 セグメント別売上高

(億円)

		修正計画	実績
売	上	高	
		170.0	171.7
	半導体製造用等精密金型	65.7	58.1
	モールディング装置	73.8	78.5
	LED樹脂封止装置・金型	9.2	13.7
	シンギュレーション装置	7.8	7.1
	ファインプラスチック成形品	13.5	14.3

リピート金型の強化

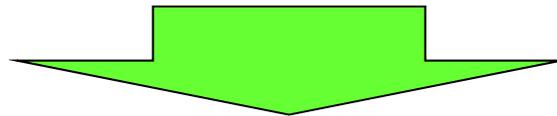
リピート金型とは？

⇒新規設計を伴わない、過去に納品した金型と(ほぼ)同じ金型

●2012年度

株式会社東進(韓国:金型工場)を連結子会社化

- ・金型生産キャパアップ
- ・リピート金型専用ラインの構築



ローカルメーカーへ流れているリピート金型の奪還

(単位:型数)

2012/3期	2013/3期	2014/3期
330	346	459

地域別売上高推移(対売上高比率)

	2012/3期	2013/3期	2014/3期
売上高	171.4	164.5	171.7
日本	19.4%	15.3%	18.4%
台湾	18.3%	20.1%	31.3%
韓国	8.3%	20.8%	10.2%
中国	19.7%	19.4%	17.1%
その他 アジア	33.0%	21.9%	19.7%
欧米	1.3%	2.5%	3.3%

設備投資・配当

(単位：百万円)

	2012/3期	2013/3期	2014/3期
設備投資	1,336	1,262	1,482
配当	5.0円	10.0円	10.0円
(連結配当性向)	(12.9%)	(36.2%)	(44.0%)

2014/3期 下期のトピック

TOWAプライベートショー 開催

ご来場実績
151社 359名

真価へ導く、
知の技術。

TOWA Core Technology leads to 'SHINKA = True Value'

2013年12月2日～2014年1月31日

展示内容

● コンプレッションモールド装置

1. CPM1080 大判□320mm対応
2. **CPM1180 超大判660×515mm対応**
3. **PMC1040 ヒートシンク付PKG対応**

● トランスファモールド装置

1. YPM1180 リリースフィルム対応

● シングュレーション装置

1. FMS3040 超高速ピックアップ仕様 (UPH45,000)
2. PSE1020 大判□320mm対応

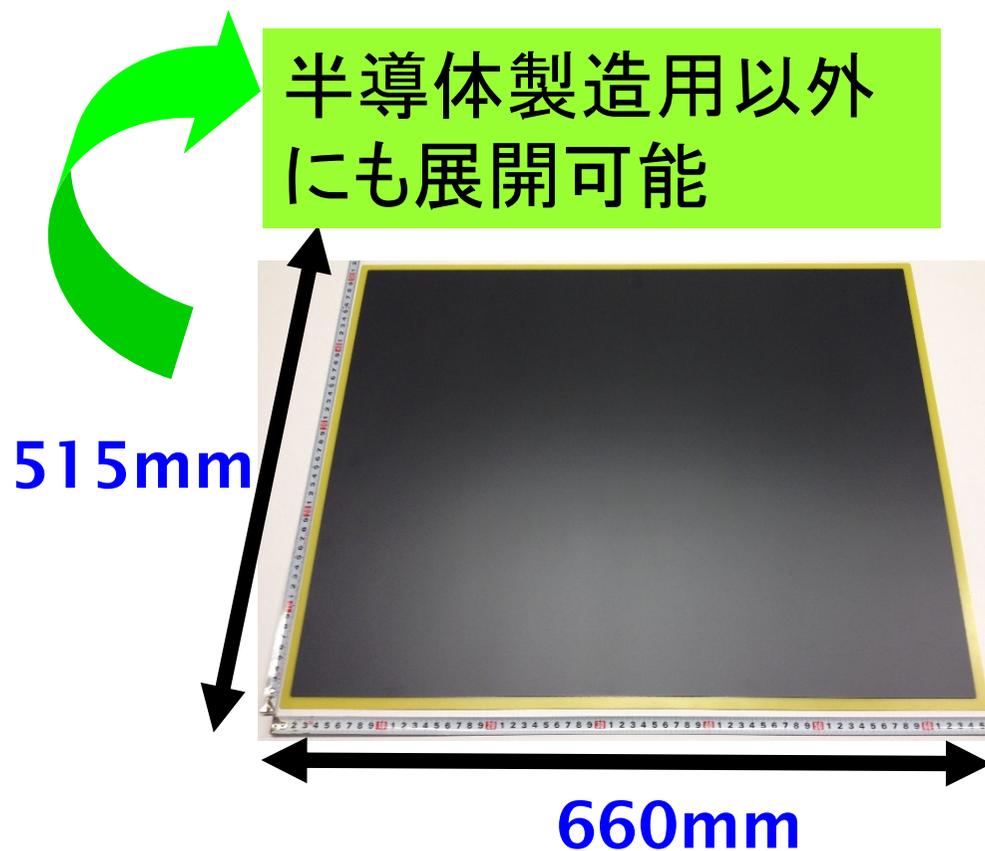
● バンセラ

超低離型抵抗の新素材金型

● ナノテクノロジーへの取り組み

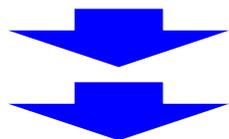
CPM 1180

- パネルサイズ $\square 660 \times 515 \text{ mm}$
ウエハーサイズ $18'' (\phi 450 \text{ mm})$ の成形可能
- **大型成形品** や **シート** の **積層成形品** の成形可能

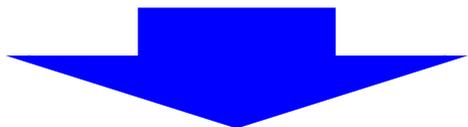


PMC 1040 HEATSINK

- コンプレッションモールドによるヒートシンク露出成形
- ヒートシンクを露出した状態で基板との同時成形可能



スマホ用プロセッサ
LTE用等高周波モジュール



電磁波を防ぐ機能
一括成形



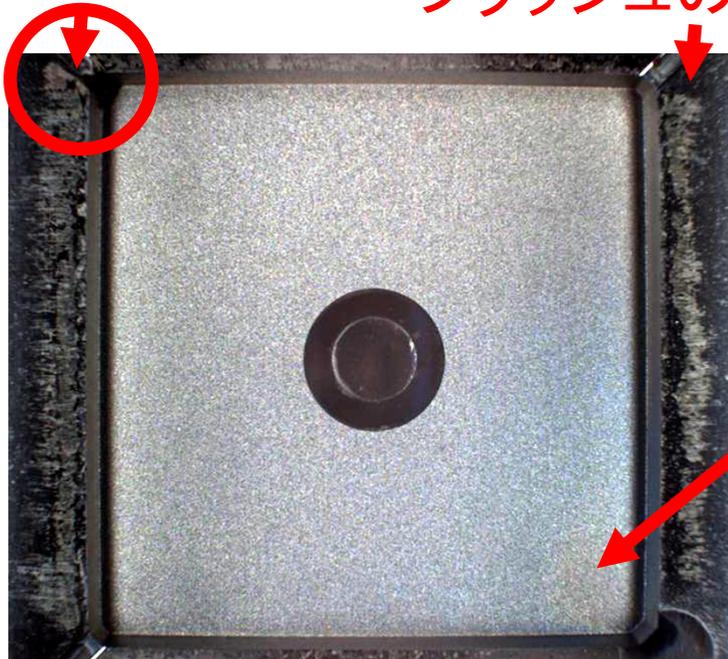
新素材金型：バンセラ

⇒ ⇒ 離型抵抗を極限まで減らした新素材

従来金型：300ショット目

樹脂の固着

フラッシュの堆積



キャビティ変色

バンセラ

1,000ショット目



2014/3期 サマリー

- **コンプレッション技術の可能性を確信**
 - ・半導体モールドでは最先端PKGに強み
 - ・幅広い分野へ展開可能
- **シンギュレーションは1歩ずつ前進**
 - ・徐々にマーケットシェアを回復
 - ・自社技術を深耕させ、収益力向上へ
- **マーケットイン体制の推進**
 - ・中国版装置 (YLC) リリース
 - ・韓国→現法設立、台湾→子会社化

2014/3期 サマリー

- R&Dへのアプローチ強化が奏功
 - ファブレスとの紐帯から新たな展開へ
 - 評価ラボ(北米、オランダ)が良いツールとなる
- 新たな事業の発掘
 - 工具販売は2月から開始
 - 新事業推進室、TSS室が奮闘中！
- TOWA10年ビジョンと新中期(3カ年)経営計画

TOWAグループ 中期経営計画(2014-2016) (Summary)

平成26年3月28日付公表

「TOWA10年ビジョン」

テーマ

ものづくり企業の「真価に挑む」

主な目標

- ◎既存事業の伸張・市場シェアアップとコア技術の応用展開
- ◎「新たな市場」創造による事業規模拡大とポートフォリオ変革
- ◎複数の世界No.1事業を保有する
- ◎人材や事業活動・形態のさらなるグローバル化
- ◎TOWAファンの倍増

TOWA10年ビジョンの 基本的な考え方

「ものづくり企業」の真の価値・・・
単に「ものづくり」の技術だけを指すものではない。

◎ ものづくり企業の「真価」とは

自らが事業活動を行い得る新たな市場を生み出す力、つまり
「市場を創造する技術力」⇒「ものづくり」企業の「真価」である。

「TOWA10年ビジョン」

数値計画

(単位:億円)

	現在	3年後	6年後	10年後
売上高	170	210	300	500
既存半導体製造装置以外比率	16%	21%	33%	50%
営業利益率	5%	10%	12%	16%

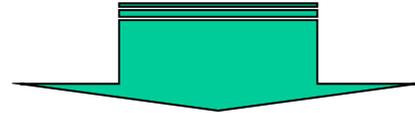
事業規模拡大と
ポートフォリオ変革

収益性の安定・向上

※既存半導体製造装置以外
=LED事業+化成品事業+「新たな市場」事業

「TOWA10年ビジョン」と 「中期経営計画」

「TOWA10年ビジョン」を具現化するためのマイルストーンとして、
3カ年の中期経営計画を策定



中期(3カ年)経営計画

基本方針

「市場を創造する」ものづくりの実践

成長戦略

中期(3カ年)経営計画

主な成長ドライバー

◎コンプレッション技術

- ・半導体モールドで圧倒的な“価値の優位性”を進める
- ・他分野への展開(車載品、電子部品)

◎シンギュレーション事業

- ・コンプレッション→モールド後のシンギュレーション市場拡大
- ・「切る」技術を展開(LED、周辺事業、その他へ展開)

◎新たな市場

- ・バンセラ(イノベーションによる市場創造)
- ・工具販売(消耗品ビジネス)
- ・TSS(サービスの事業化)
- ・その他既存事業以外の新たな市場を掘り出し

基盤強化

中期(3カ年)経営計画

《営業活動網・活動形態の再構築》

- ◎販社自活プロジェクト
- ◎本社・販社・現地代理店の業務・役割の見直し
- ◎営業活動における収益力の改善

《高効率生産体制の追求》

- ◎為替変動(円安)への対応
- ◎適地生産体制、各事業会社の活用とコスト追求
- ◎開発と生産の連携

《グローバルリーダーの育成》

- ◎世界を舞台に活躍するグローバルリーダーが必要
- ◎技術・製品知識、マーケティング力、マネジメント力、語学力
- ◎高度人材育成による開発力強化
- ◎「個」の能力向上によるグループガバナンスの強化

中期(3カ年)数値計画

(単位:億円)

		2015/3期	2016/3期	2017/3期
売	上 高	180	190	210
売	半導体製造装置事業	155	160	165
	半導体製造用精密金型	59	60	62
上	モールディング装置	88	91	93
	シンギュレーション	8	9	10
高	L E D 事業	11	12	15
	化成品事業	12	13	15
内	「新たな市場」事業	2	5	15
記				

中期（3カ年）数値計画

（単位：億円）

	2015/3期	2016/3期	2017/3期
売上高	180	190	210
営業利益	10	15	21
経常利益	9	14	20
当期純利益	8	13	14
配当方針	安定・継続配当		

2015/3期 取組み・計画

- 上半期は好調→台湾、韓国勢が牽引
- 下期も大崩れはない→保守的に見ている
- 「新たな市場」事業は着実に進行させる

業績計画

(単位:億円)

	上期	下期	通期
売上高	100.0	80.0	180.0
営業利益	8.5	1.5	10.0
経常利益	8.0	1.0	9.0
当期純利益	7.5	0.5	8.0

2015/3期

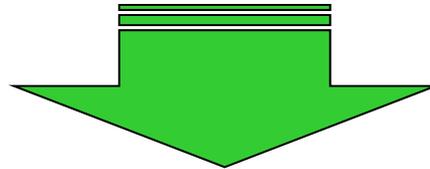
設備投資・配当計画

(単位：百万円)

		計 画
設 備 投 資		1, 3 0 0
年 間 配 当		1 0. 0 円

中期(3カ年)経営計画

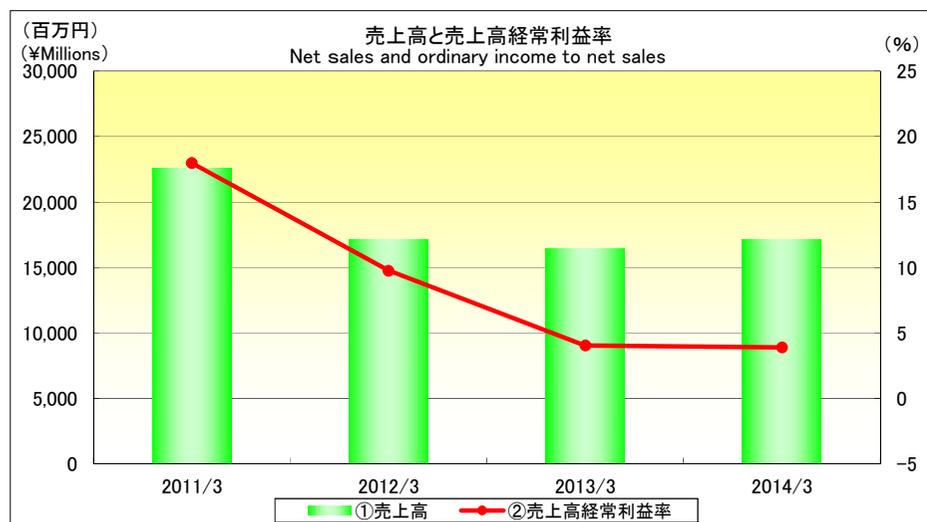
「市場を創造する」ものづくりの実践



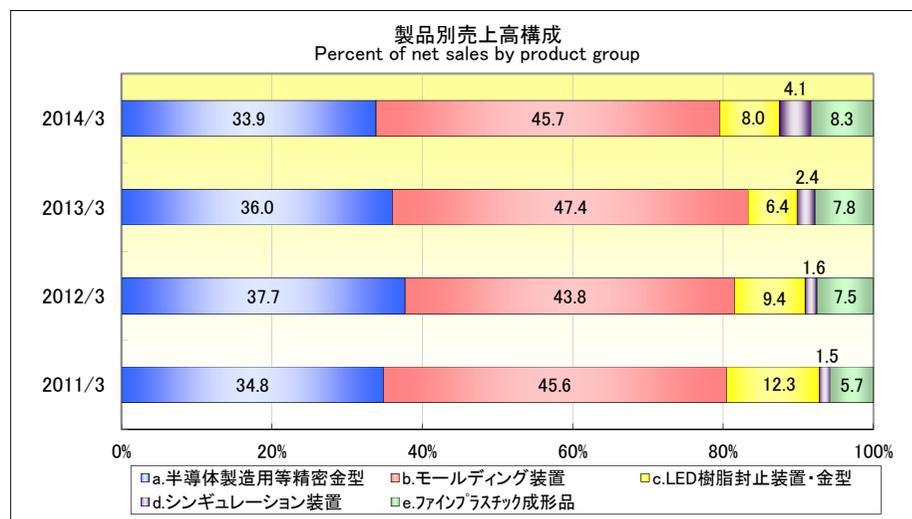
「TOWA10年ビジョン」

- ◎既存事業の伸張・市場シェアアップとコア技術の応用展開
- ◎「新たな市場」創造による事業規模拡大とポートフォリオ変革
- ◎複数の世界No.1事業を保有する
- ◎人材や事業活動・形態のさらなるグローバル化
- ◎TOWAファンの倍増

I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)



①Net sales ②Ordinary income to net sales

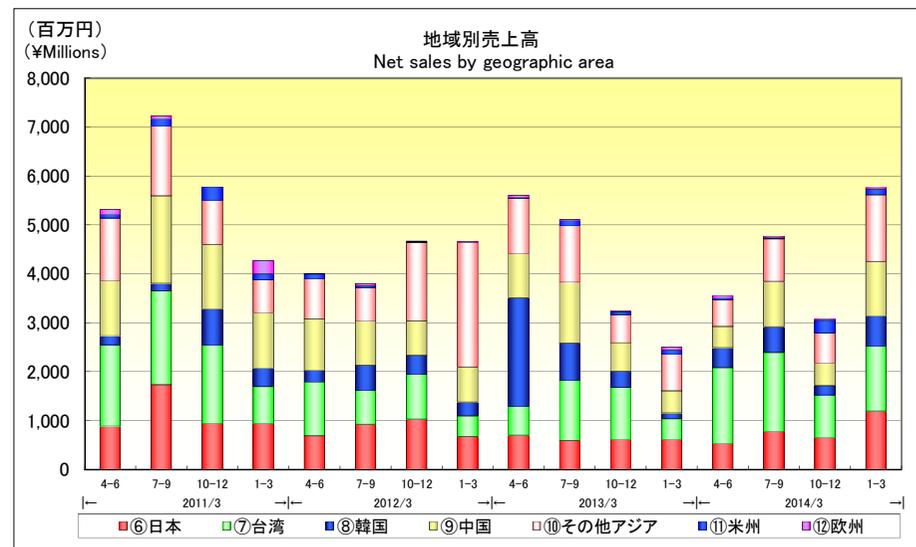
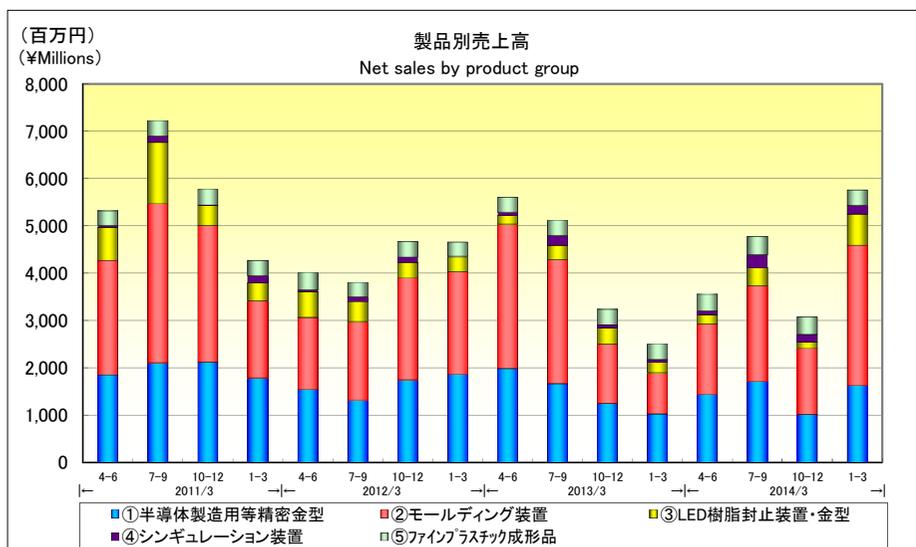


a.Precision molds b.Semiconductor plastic encapsulation systems c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED
d.Singulation parts and systems e. Engineering plastic molded products

決算期	Fiscal year	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3	2013/9
経営成績・財政状態 (百万円)	Operating results and financial conditions (¥Millions)					
売上高	Net sales	22,592	17,140	16,454	17,165	8,328
経常利益	Ordinary income	4,064	1,672	663	666	100
当期純利益	Net income	3,751	968	691	568	52
総資産	Total assets	27,288	26,817	25,896	29,132	27,210
純資産	Net assets	14,771	15,926	17,072	17,909	17,207
1株当たり指標(円)	Per share data(¥)					
1株当たり当期純利益	Net income per share	150.00	38.71	27.64	22.72	2.10
諸指標(%)	Data(%)					
自己資本当期純利益率	Return on equity	29.0	6.3	4.2	3.3	-
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	15.0	6.2	2.5	2.4	-
売上高経常利益率	Ordinary income to net sales	18.0	9.8	4.0	3.9	1.2
自己資本比率	Equity ratio	54.1	59.4	65.2	60.6	62.4

(単位:百万円/¥Millions)

II. 四半期売上高動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



製品別売上高 Net sales by product group

(単位:百万円/¥Millions)

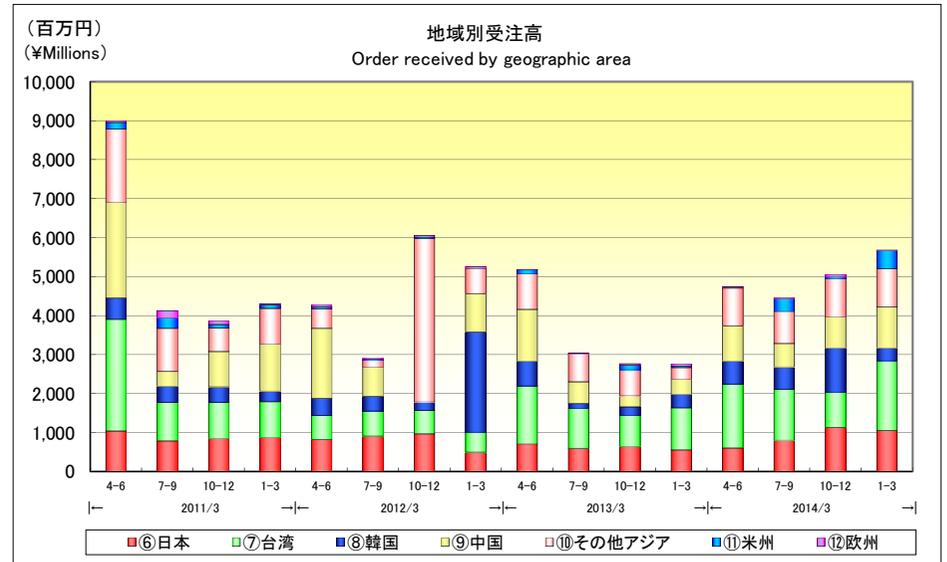
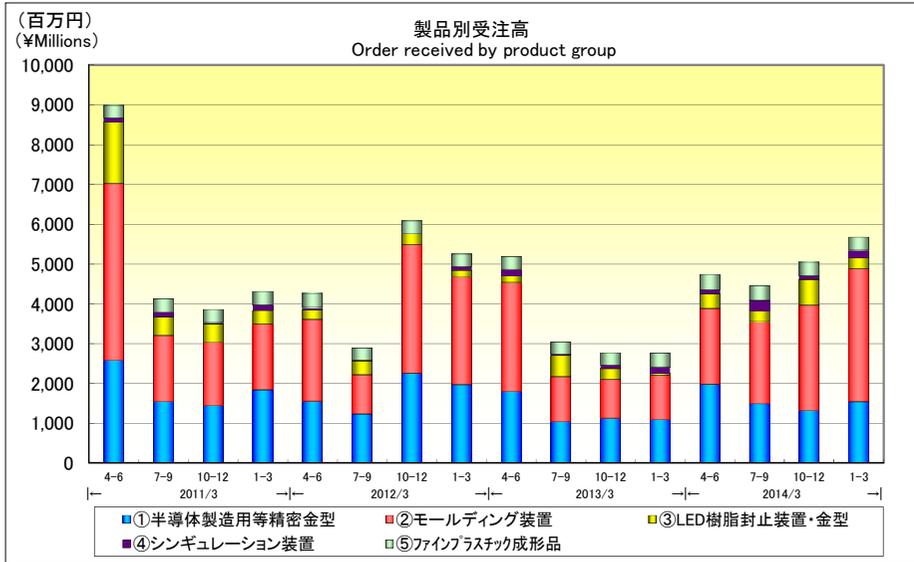
決算期 Fiscal year	2011/3					2012/3					2013/3					2014/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計 Total sales	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140	5,604	5,111	3,237	2,501	16,454	3,555	4,772	3,076	5,761	17,165
半導体製造用等精密金型 ①Precision molds	1,852	2,104	2,121	1,787	7,866	1,537	1,320	1,745	1,859	6,462	1,984	1,665	1,247	1,026	5,923	1,443	1,723	1,009	1,634	5,810
モールドング装置 ②Semiconductor plastic encapsulation systems	2,421	3,371	2,888	1,630	10,313	1,529	1,657	2,152	2,173	7,513	3,052	2,623	1,254	870	7,801	1,479	2,007	1,406	2,958	7,852
LED樹脂封止装置・金型 ③Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	698	1,290	420	377	2,786	544	418	333	312	1,608	187	299	347	220	1,055	197	378	133	657	1,367
シンギュレーション装置 ④Singulation parts and systems	40	127	13	155	337	38	104	111	12	267	67	204	65	57	395	82	285	158	182	710
ファインプラスチック成形品 ⑤Engineering plastic molded products	304	332	332	319	1,289	359	303	323	301	1,287	311	318	322	325	1,277	351	377	367	327	1,424
月平均	1,772	2,409	1,926	1,424	1,883	1,336	1,268	1,555	1,553	1,428	1,868	1,704	1,079	834	1,371	1,185	1,591	1,025	1,920	1,430

地域別売上高 Net sales by geographic area

(単位:百万円/¥Millions)

決算期 Fiscal year	2011/3					2012/3					2013/3					2014/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計 Total sales	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592	4,009	3,803	4,665	4,660	17,140	5,604	5,111	3,237	2,501	16,454	3,555	4,772	3,076	5,761	17,165
日本 ⑥Japan	889	1,735	936	943	4,507	688	925	1,030	675	3,320	702	590	614	614	2,521	527	772	654	1,195	3,150
台湾 ⑦Taiwan	1,661	1,920	1,611	751	5,945	1,103	695	912	421	3,132	595	1,227	1,068	423	3,314	1,556	1,619	873	1,326	5,376
韓国 ⑧Korea	187	152	737	380	1,458	237	510	393	282	1,423	2,215	764	329	119	3,428	408	528	189	618	1,745
中国 ⑨China	1,125	1,786	1,319	1,130	5,363	1,050	903	701	718	3,374	903	1,248	583	453	3,189	436	926	462	1,116	2,941
その他アジア ⑩Other asia	1,279	1,431	904	675	4,291	823	688	1,598	2,539	5,649	1,129	1,151	575	748	3,604	543	870	609	1,361	3,384
米州 ⑪America	70	145	268	117	602	94	32	25	11	164	14	112	53	89	269	31	20	263	112	428
欧州 ⑫Europe	103	55	0	270	423	10	47	4	11	74	44	16	12	52	126	51	34	23	29	137

Ⅲ. 四半期受注高動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



製品別受注高 Order received by product group

(単位: 百万円/¥Millions)

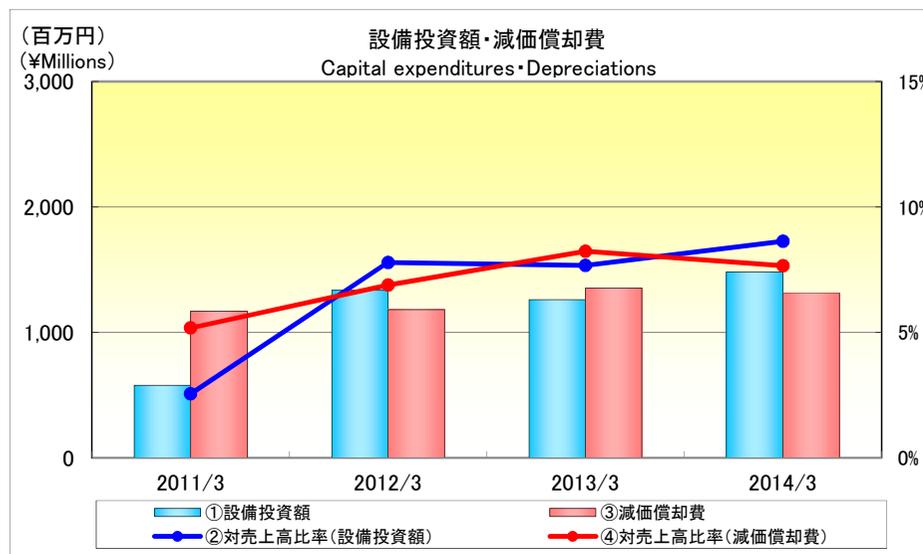
決算期 Fiscal year	2011/3					2012/3					2013/3					2014/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
受注高合計 Total order received	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	5,190	3,039	2,766	2,763	13,759	4,740	4,454	5,048	5,677	19,921
半導体製造用等精密金型 ① Precision molds	2,587	1,554	1,455	1,841	7,438	1,558	1,236	2,263	1,969	7,028	1,797	1,052	1,131	1,101	5,083	1,980	1,490	1,326	1,539	6,336
モールドング装置 ② Semiconductor plastic encapsulation systems	4,437	1,651	1,587	1,657	9,334	2,055	982	3,221	2,720	8,978	2,741	1,119	970	1,103	5,934	1,904	2,067	2,643	3,339	9,954
LED樹脂封止装置・金型 ③ Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	1,546	465	454	335	2,801	227	348	289	147	1,013	168	529	270	53	1,021	365	275	642	273	1,556
シンギュレーション装置 ④ Singulation parts and systems	101	132	35	142	411	73	16	-29	103	164	160	30	90	158	439	107	257	101	198	664
ファインプラスチック成形品 ⑤ Engineering plastic molded products	316	327	326	327	1,298	350	307	309	313	1,281	322	306	304	346	1,279	383	362	335	327	1,409
月平均	2,996	1,377	1,286	1,435	1,774	1,422	964	2,018	1,752	1,539	1,730	1,013	922	921	1,147	1,580	1,485	1,683	1,892	1,660

地域別受注高 Order received by geographic area

(単位: 百万円/¥Millions)

決算期 Fiscal year	2011/3					2012/3					2013/3					2014/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
受注高合計 Total order received	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285	4,265	2,891	6,053	5,255	18,466	5,190	3,039	2,766	2,763	13,759	4,740	4,454	5,048	5,677	19,921
日本 ⑥ Japan	1,038	781	853	875	3,548	821	906	963	495	3,187	703	593	645	551	2,494	602	802	1,130	1,048	3,583
台湾 ⑦ Taiwan	2,863	992	921	913	5,691	615	642	602	512	2,372	1,492	1,027	793	1,079	4,392	1,639	1,299	894	1,793	5,626
韓国 ⑧ Korea	546	415	395	277	1,635	435	375	219	2,573	3,604	637	119	219	352	1,328	592	583	1,139	330	2,645
中国 ⑨ China	2,456	376	907	1,198	4,938	1,801	746	-8	981	3,520	1,327	564	284	389	2,566	902	598	794	1,046	3,341
その他アジア ⑩ Other asia	1,886	1,108	601	921	4,518	503	196	4,202	657	5,559	912	704	668	293	2,579	966	823	990	989	3,770
米州 ⑪ America	168	268	95	90	623	44	19	27	25	117	99	16	112	34	263	17	330	49	467	864
欧州 ⑫ Europe	29	188	84	26	329	43	4	46	9	104	16	13	42	62	134	20	16	50	2	89

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結)		(単位: 百万円/¥Millions)			
決算期	Fiscal year	2011/3	2012/3	2013/3	2014/3
キャッシュフロー	Cash flows				
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	5,571	1,897	2,710	935
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-620	-112	-1,083	-1,553
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	-3,808	-2,280	-817	819
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents	4,933	4,395	5,266	5,533
設備投資額	①Capital expenditures	578	1,336	1,262	1,482
対売上高比率(%)	②Ratio of sales (%)	2.56	7.79	7.67	8.64
減価償却費	③Depreciations	1,170	1,181	1,354	1,314
対売上高比率(%)	④Ratio of sales (%)	5.18	6.89	8.23	7.66
研究開発費	⑤Research and development expenses	330	238	187	129
対売上高比率(%)	⑥Ratio of sales (%)	1.46	1.39	1.14	0.75

この資料に関するお問い合わせ

TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5

Tel : 075-692-0251

Fax: 075-692-0270

http://www.towajapan.co.jp/contact/i_ir/index.htm

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。